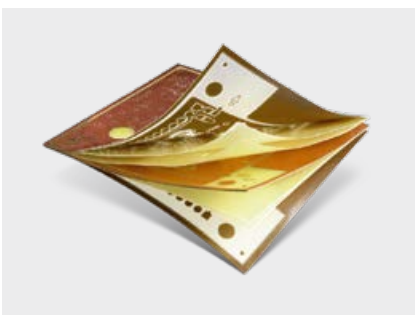


多层板压合设备

LPKF MultiPress S4

- 刚性板, 刚柔结合板, 柔性板以及射频材料的实验室内的多层板压合
- 先进的智能操作界面嵌入触摸屏以及引导功能
- 多达五种可任意编辑的温度/压力曲线控制
- 内置真空液压装置以及吸尘装置
- 独立系统, 结构紧凑, 易移动



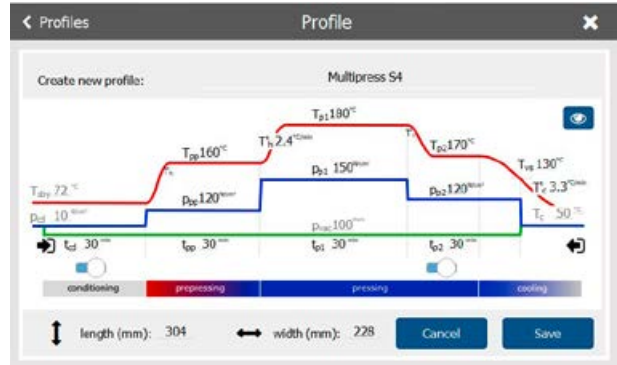
LPKF

实验室自行完成最高可达八层的电路板制作

随着封装技术的日新月异,对外围电路板的要求也越来越高。高密度互连的电路结构也必然要求电路层数越多越好。所以,对设计者而言,在实验室自行制作多层板已经逐渐成为一种趋势。

新一代多层板压合设备 LPKF MultiPress S4 操作界面直观便捷,为多层板的制作奠定了良好基础,同时为新材料的工艺制程提供了更多可能性。通过三到五个步骤的即可实现层压温度曲线和压力的控制,也可实现抽真空和快速冷却。

LPKF MultiPress S4 采用单相电运行,内置真空和液压泵,预置的程序包含了常见材料的压合工艺参数,是实验室制作多层板的最佳选择,设备还配有通风系统,层压过程的任何烟雾或气味都可以直接排出。



LPKF MultiPress S4

最大加工幅面	200 mm x 275 mm (7.8" x 10.8")
最大层压区域	229 mm x 305 mm (9" x 12")
最小层压区域	100 mm x 100 mm (4" x 4")
最大层压压强	340 N/cm ² (229 mm x 305 mm (9" x 12"))
最高温度	320 °C (608 °F)
真空调整	可关闭, 开启范围 0.1 – 0.9 bar (1.5 – 13 PSI)
电路板层数	最高可加工至八层 (与材料和布线有关)
最高堆叠厚度	4 mm (0.16")
层压预置曲线数量	无材料限制, 多达5个预置曲线控制
外形尺寸 (W x H x D)	500 mm x 980 mm x 500 mm (19.7" x 38.6" x 19.7")
重量	205 kg (452 lbs)
电源	207 – 230 AC, 3 kW

LPKF Laser & Electronics SE (Headquarters)

Osteriede 7 30827 Garbsen Germany

Phone +49 (5131) 7095-0 info@lpkf.com www.lpkf.com

乐普科 (上海) 光电有限公司

电话: +86 (21) 3950 1051 邮箱: sales.china@lpkf.com 网址: www.lpkf.cn

上海市嘉定区金沙江西路 1555 弄慧创国际 390 号 2 楼 邮编: 201803

WeChat



www.lpkf.com/multipress-s4